



Title of Change:	Mold compound change due to End of Life of Samsung SDI molding compound – Batch 2	
Proposed First Ship date:	4 January 2020	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.Support@onsemi.com >	
Samples:	Samples should be available after completion of qualification. Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.Samples@onsemi.com > Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < PCN.Support@onsemi.com >	
Change Part Identification:	Product with date code 2001 or newer will be assembled with a new mold compound.	
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☒ Assembly Change ☐ Test Change ☐ Other _____	
Change Sub-Category(s):	☐ Manufacturing Site Addition ☒ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☐ Shipping/Packaging/Marking ☐ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Tarlac City, Philippines	External Foundry/Subcon Sites: ASE Weihai AUK Dalian Ocean Fine Shantou Huashan Electronic Devices SP Semiconductor and Communications Tak Cheong Electronics Shanwei Universal Global Scientific Industrial

**Description and Purpose:**

ON Semiconductor would like to inform its customers of a change in the mold compound for the devices listed in this IPCN. This change is a result of an end of life notification received for Samsung SDI EMC. The replacement mold compound is still being decided for many packages and will be declared on the Final Product Change Notification, which will be sent out 97 days prior to its implementation.

	Before Change Description	After Change Description
Mold Compound (TO220F-4 Package)	Samsung ST-7100HS	TBD
Mold Compound (TO220-2 Package)	Samsung SL7300HFM/SI7200DX2/SG8200DL/SG8300HK	TBD
Mold Compound (TO220F-3 Package)	Samsung SL7300HFM/SI7200DX2/SG8200DL/SG8300HK	TBD
Mold Compound (TO3P-5 Package)	Samsung SI7200DX2	TBD
Mold Compound (TO3P-3 Package)	Samsung SL7300HXM/SI7200DX2/SG8200DL	TBD
Mold Compound (TO264-3 Package)	Samsung SL7300HFM	TBD
Mold Compound (TO247-2 Package)	Samsung SG8200DL/SL7300HFM	TBD
Mold Compound (TO247-3 Package)	Samsung SG8200DL/SL7300HFM	TBD
Mold Compound (TP247-3 Package)	Samsung SG8200DL	TBD
Mold Compound (TP247-4 Package)	Samsung SG8200DL/SL7300HFM	TBD
Mold Compound (D2PAK-3 Package)	Samsung SG8200DL	Sumitomo EME-G700HF
Mold Compound (SPM5 Package)	Samsung SL7300HW	KCC KTMC3100GP3
Mold Compound (SPM3 Package)	Samsung SL7300HW	TBD

The qualifications will be completed as quickly as possible, but due to the number of qualifications being performed, multiple Final Product Change Notifications (FPCNs) will be released to customers as the various packages/locations are qualified.

There is no product marking change as a result of this change.

**Qualification Plan:**

All Packages will follow the generic plans shown below based on Package type and application:

IC non-auto:

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta= TBD °C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= max Tj stg °C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= - 65°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _____ @ _____ °C (per datasheet as required)	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Discrete non-auto:

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= max Tj°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= max Tj°C, 100% max rated Vgss (tech specific)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= max Tj stg	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = TBD by pkg min	TBD cyc determined by pkg
TC	JESD22-A104	Ta= - 65°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _____ @ _____ °C as required by MSL level on datasheet (SMT)	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Estimated date for qualification completion: 30 August 2019 For first packages with additional qualifications after this date.

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
KSC2330OTA	TBD
KSC2330YTA	TBD
KSC2331YTA	TBD
KSC2333YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC2334Y	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC2334YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC2383OTA	TBD
KSC2383YTA	TBD
KSC2690AYS	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSC2690AYSTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSC2752OSTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSC3503DS	KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
KSC3503DSTU	KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
KSC5021RTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5026MOS	TBD
KSC5027OTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5305DTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5338D	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5338DTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5402DTTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5502DTTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5502TU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5603DTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD1691GS	FJE5304D, KSA1142OSTU
KSD1691GSTU	KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
KSD1691YS	KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
KSD1691YSTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSD1692YS	FJE5304D, KSA1142OSTU
KSD363RTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD363YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD526Y	KSC5603DTU, KSC5338D



Initial Product/Process Change Notification

Document # : IPCN22647XA

Issue Date: 20 March 2019

KSD526YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD560RTSTU	KSC5603DTU
KSD560RTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD560YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD794AYSTU	FJE5304D, KSA1142OSTU
KSD880O	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD880YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD882YS	KSE13003H1ASTU, KSA1156YS, KSB1151YS
KSD882YSTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
KSE13003H1ASTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSE13003H2ASTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSE13003TH1ATU	KSC5603DTU
KSE13009TU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSE210STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
KSE340STU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSE350STU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSA1156YS
KSE44A11TU	KSC5603DTU
KSE44H11	KSC5338D
KSE44H11TU	KSC5603DTU
KSE45H11	KSC5338D
KSE45H11TU	KSC5338D
KSE45H8TU	KSC5338D
KSE800STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
MJE180STU	KSB1151YS, KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
MJE181STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
MJE182STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
MJE200STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
MJE210STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
MJE2955TTU	KSC5603DTU, KSC5338D
MJE3055TTU	KSC5603DTU, KSC5338D
MJE340STU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
MJE350STU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSA1156YS
MJE800STU	KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
TIP105TU	KSC5603DTU
TIP110TU	KSC5603DTU
TIP111TU	KSC5603DTU



TIP112TU	KSC5603DTU
TIP120TU	KSC5603DTU
TIP121TU	KSC5603DTU
TIP125TU	KSC5603DTU
TIP126TU	KSC5603DTU
TIP142TTU	KSC5603DTU
TIP147T	KSC5603DTU
TIP147TTU	KSC5603DTU
TIP29	KSC5603DTU
TIP32ATU	KSC5603DTU
TIP48TU	KSC5603DTU
TIP49	KSC5603DTU
D44H11G	MJE5852G
D44H8G	MJE5852G
D44VH10G	MJE5852G
D45H11G	MJE5852G
D45H8G	MJE5852G
D45VH10G	MJE5852G
MJE5850G	MJE5852G
MJE5851G	MJE5852G
MJE5852G	MJE5852G
MJF122G	MJF18008G
MJF127G	MJF18008G
MJF15030G	MJF18008G
MJF15031G	MJF18008G
MJF18004G	MJF18008G
MJF18008G	MJF18008G
MJF2955G	MJF18008G
MJF3055G	MJF18008G
MJF31CG	MJF18008G
MJF32CG	MJF18008G
MJF44H11G	MJF18008G
MJF45H11G	MJF18008G
MJF47G	MJF18008G
MJF6388G	MJF18008G
MJL1302AG	MJL4302AG



Initial Product/Process Change Notification

Document # : IPCN22647XA

Issue Date: 20 March 2019

MJL21193G	MJL4302AG
MJL21194G	MJL4302AG
MJL21195G	MJL4302AG
MJL21196G	MJL4302AG
MJL3281AG	MJL4302AG
MJL4281AG	MJL4302AG
MJL4302AG	MJL4302AG
NJL0281DG	MJL4302AG
NJL0302DG	MJL4302AG
NJL1302DG	MJL4302AG
NJL3281DG	MJL4302AG
NJW0281G	NJW1302G
NJW0302G	NJW1302G
NJW1302G	NJW1302G
NJW21193G	NJW1302G
NJW21194G	NJW1302G
NJW3281G	NJW1302G
NJW44H11G	NJW1302G
TIP29AG	MJE5852G
TIP29BG	MJE5852G
TIP29CG	MJE5852G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22647XA

発行日 : 19 March 2019

変更件名:	Samsung SDI 製モールド コンパウンド - Batch 2 の生産終了に伴うモールド コンパウンドの変更	
初回出荷予定日:	4 January 2020	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	サンプルは認定完了後に提供が可能となります。 現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。	
変更部品の識別:	日付コード 2001 以降の製品は、新しいモールド コンパウンドで組み立てられます	
変更カテゴリ:	☐ ウェハファブの変更 ☒ アセンブリの変更 ☐ 試験の変更 ☐ その他 _____	
変更サブカテゴリ:	☐ 製造拠点の追加 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製造プロセスの変更 ☒ 材料の変更 ☐ 製品仕様の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☐ 出荷/パッケージング/表記 ☐ その他 : _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Tarlac City, Philippines	外部製造工場 / 下請業者拠点: ASE Weihai AUK Dalian Ocean Fine Shantou Huashan Electronic Devices SP Semiconductor and Communications Tak Cheong Electronics Shanwei Universal Global Scientific Industrial



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22647XA

発行日 : 19 March 2019

説明および目的:

オン・セミコンダクターは、本 IPCN に列記されたデバイスに対するモールドコンパウンドの変更をお客様にお知らせいたします。この変更は、Samsung SDI EMC から受けた生産終了の通知によるものです。代替のモールドコンパウンドは、多くのパッケージ用に使用すると決定されているもので、実施の 97 日前までに送付される最終製品変更通知にて公表されます。

	変更前の表記	変更後の表記
モールド・コンパウンド (TO220F-4 パッケージ)	Samsung ST-7100HS	TBD
モールド・コンパウンド (TO220-2 パッケージ)	Samsung SL7300HFM/SI7200DX2/SG8200DL/SG8300HK	TBD
モールド・コンパウンド (TO220F-3 パッケージ)	Samsung SL7300HFM/SI7200DX2/SG8200DL/SG8300HK	TBD
モールド・コンパウンド (TO3P-5 パッケージ)	Samsung SI7200DX2	TBD
モールド・コンパウンド (TO3P-3 パッケージ)	Samsung SL7300HXM/SI7200DX2/SG8200DL	TBD
モールド・コンパウンド (TO264-3 パッケージ)	Samsung SL7300HFM	TBD
モールド・コンパウンド (TO247-2 パッケージ)	Samsung SG8200DL/SL7300HFM	TBD
モールド・コンパウンド (TO247-3 パッケージ)	Samsung SG8200DL/SL7300HFM	TBD
モールド・コンパウンド (TP247-3 パッケージ)	Samsung SG8200DL	TBD
モールド・コンパウンド (TP247-4 パッケージ)	Samsung SG8200DL/SL7300HFM	TBD
モールド・コンパウンド (D2PAK-3 パッケージ)	Samsung SG8200DL	Sumitomo EME-G700HF
モールド・コンパウンド (SPM5 パッケージ)	Samsung SL7300HW	KCC KTCM3100GP3
モールド・コンパウンド (SPM3 パッケージ)	Samsung SL7300HW	TBD

認定に関してはできる限り早急に終了する予定ですが、各種パッケージ/場所が認定されることになり、実施される認定が多数になるため、複数の最終製品変更通知 (FPCNs) がお客様に発行されることになります。

今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。



認定計画:

すべてのパッケージは、パッケージタイプおよびアプリケーションに基づき以下に示す一般計画に従います。

IC 非車載:

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta= TBD °C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= max Tj stg °C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= - 65°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _____ @ _____ °C (per datasheet as required)	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

ディスクリート非車載:

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= max Tj°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= max Tj°C, 100% max rated Vgss (tech specific)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= max Tj stg	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = TBD by pkg min	TBD cyc determined by pkg
TC	JESD22-A104	Ta= - 65°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _____ @ _____ °C as required by MSL level on datasheet (SMT)	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

認定完了予定日: 2019 年 8 月 30 日 この日付以降の追加認定に基づく初期パッケージに関して。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22647XA

発行日 : 19 March 2019

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
KSC2330OTA	TBD
KSC2330YTA	TBD
KSC2331YTA	TBD
KSC2333YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC2334Y	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC2334YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC2383OTA	TBD
KSC2383YTA	TBD
KSC2690AYS	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSC2690AYSTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSC2752OSTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSC3503DS	KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
KSC3503DSTU	KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
KSC5021RTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5026MOS	TBD
KSC5027OTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5305DTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5338D	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5338DTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5402DTTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5502DTTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5502TU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSC5603DTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD1691GS	FJE5304D, KSA1142OSTU
KSD1691GSTU	KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
KSD1691YS	KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
KSD1691YSTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSD1692YS	FJE5304D, KSA1142OSTU
KSD363RTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD363YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD526Y	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD526YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD560RTSTU	KSC5603DTU



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22647XA

発行日 : 19 March 2019

KSD560RTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD560YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD794AYSTU	FJE5304D, KSA1142OSTU
KSD8800	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD880YTU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSD882YS	KSE13003H1ASTU, KSA1156YS, KSB1151YS
KSD882YSTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
KSE13003H1ASTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSE13003H2ASTU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSE13003TH1ATU	KSC5603DTU
KSE13009TU	KSC5603DTU, KSC5338D
KSE210STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
KSE340STU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
KSE350STU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSA1156YS
KSE44A11TU	KSC5603DTU
KSE44H11	KSC5338D
KSE44H11TU	KSC5603DTU
KSE45H11	KSC5338D
KSE45H11TU	KSC5338D
KSE45H8TU	KSC5338D
KSE800STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
MJE180STU	KSB1151YS, KSE13003H1ASTU, KSA1156YS
MJE181STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
MJE182STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
MJE200STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
MJE210STU	FJE5304D, KSA1142OSTU
MJE2955TTU	KSC5603DTU, KSC5338D
MJE3055TTU	KSC5603DTU, KSC5338D
MJE340STU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
MJE350STU	FJE5304D, KSA1142OSTU, KSB1151YS, KSA1156YS
MJE800STU	KSB1151YS, KSE13003H1ASTU
TIP105TU	KSC5603DTU
TIP110TU	KSC5603DTU
TIP111TU	KSC5603DTU
TIP112TU	KSC5603DTU
TIP120TU	KSC5603DTU
TIP121TU	KSC5603DTU
TIP125TU	KSC5603DTU



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22647XA

発行日 : 19 March 2019

TIP126TU	KSC5603DTU
TIP142TTU	KSC5603DTU
TIP147T	KSC5603DTU
TIP147TTU	KSC5603DTU
TIP29	KSC5603DTU
TIP32ATU	KSC5603DTU
TIP48TU	KSC5603DTU
TIP49	KSC5603DTU
D44H11G	MJE5852G
D44H8G	MJE5852G
D44VH10G	MJE5852G
D45H11G	MJE5852G
D45H8G	MJE5852G
D45VH10G	MJE5852G
MJE5850G	MJE5852G
MJE5851G	MJE5852G
MJE5852G	MJE5852G
MJF122G	MJF18008G
MJF127G	MJF18008G
MJF15030G	MJF18008G
MJF15031G	MJF18008G
MJF18004G	MJF18008G
MJF18008G	MJF18008G
MJF2955G	MJF18008G
MJF3055G	MJF18008G
MJF31CG	MJF18008G
MJF32CG	MJF18008G
MJF44H11G	MJF18008G
MJF45H11G	MJF18008G
MJF47G	MJF18008G
MJF6388G	MJF18008G
MJL1302AG	MJL4302AG
MJL21193G	MJL4302AG
MJL21194G	MJL4302AG
MJL21195G	MJL4302AG
MJL21196G	MJL4302AG
MJL3281AG	MJL4302AG
MJL4281AG	MJL4302AG



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22647XA

発行日 : 19 March 2019

MJL4302AG	MJL4302AG
NJL0281DG	MJL4302AG
NJL0302DG	MJL4302AG
NJL1302DG	MJL4302AG
NJL3281DG	MJL4302AG
NJW0281G	NJW1302G
NJW0302G	NJW1302G
NJW1302G	NJW1302G
NJW21193G	NJW1302G
NJW21194G	NJW1302G
NJW3281G	NJW1302G
NJW44H11G	NJW1302G
TIP29AG	MJE5852G
TIP29BG	MJE5852G
TIP29CG	MJE5852G